



## 智能自動晶圓厚度量測設備

多功能晶圓量測儀，採上下高精度白光共軛焦感測器  
進行晶圓之厚度、翹曲度等量測

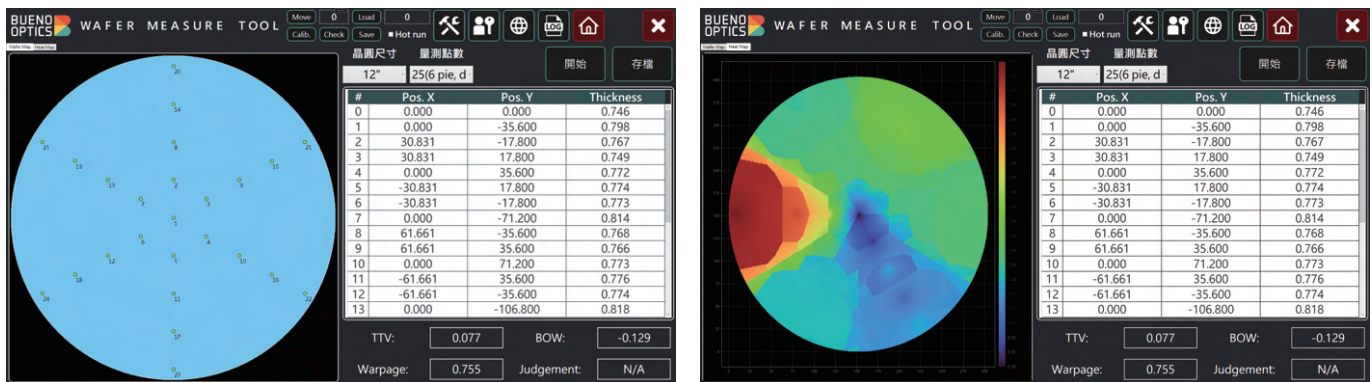


## 智能自動晶圓厚度量測設備

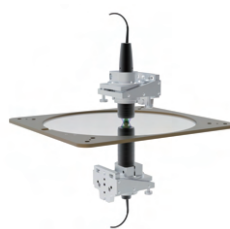
- 針對半導體晶圓研磨、減薄製程、CVD進行沈積、晶磊和長膜過程之厚度監控需求。
- 製程中所產生晶圓弓度、翹曲度及厚度均勻提供精準量測分析。
- 利用非接觸式感測器，搭配高精度位移平台進行全平面掃描。
- 工單可以採用條碼方式提供，可依據客戶格式自動讀取條碼，自動載入量測參數進行量測。
- 感測頭採用非接觸式高精度雙頭感測器。

## 量測設備功能

可自定義量測點數，軟體內建點數路徑，包含5點、9點、37點及自訂義點數，可達成多點位的量測資訊；系統亦可讀取晶圓的 WAFER ID 資訊。



適用於：半導體晶圓產業，採上下高精度白光共軛焦感測器進行晶圓之厚度、翹曲度等量測。



[ 對照式雙測頭白光共軛焦模組 ]

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 型號       | 多功能晶圓量測儀               |
| 晶圓厚度量測項目 | THK / TTV / WARP / BOW |
| 感測器解析度   | ±0.5μm                 |
| 重複精度     | ±3μm                   |
| 晶圓厚度量測範圍 | 50μm-1000μm            |